

トップUBPプロセスW

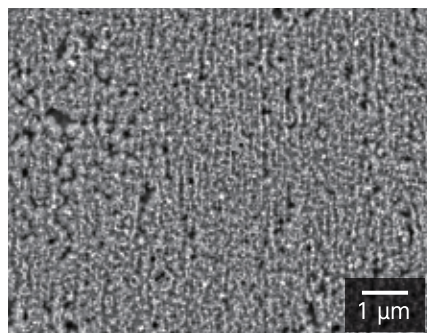
TOP UBP PROCESS W

- ジンケートが緻密に析出し、めっき平滑性に優れる
Make zincate film finely, improve the smoothness of nickel films
- アルミスパッタ膜の局部腐食を抑制する前処理プロセス
Prevent local corrosion and nickel spike in pre-treatment process for aluminum- and aluminum-alloy sputtering layer
- 無電解ニッケル皮膜は、400℃の熱処理後においても耐クラック性に優れる
Prevent cracks even after heat treatment at 400℃

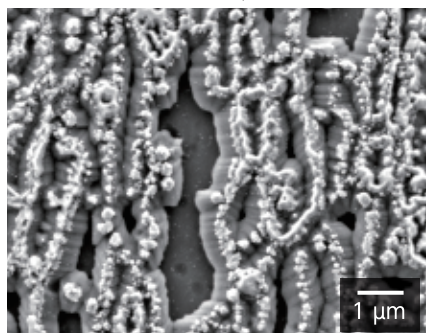
アルミニウム電極上に均一な皮膜を形成

Fine and uniform plating film on aluminum electrodes

トップUBPプロセスW
TOP UBP PROCESS W

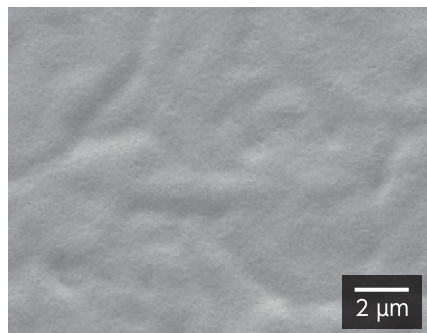


従来プロセス
Conventional process

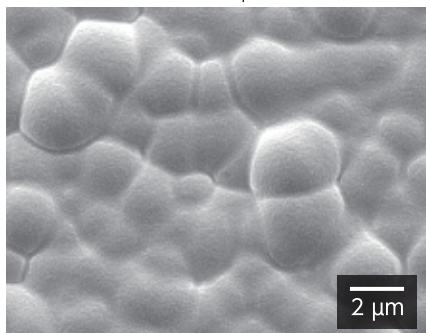


第2ジンケート後の表面SEM像
SEM image of surface(after 2nd zincate)

トップUBPプロセスW
TOP UBP PROCESS W



従来プロセス
Conventional process

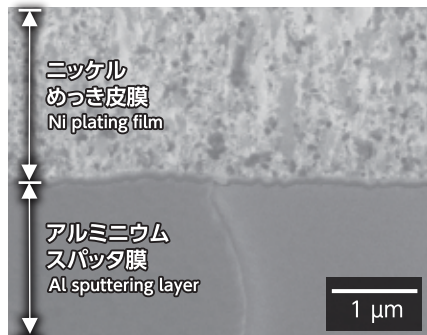


無電解ニッケルめっき後の表面SEM像
SEM image of surface(after electroless nickel plating)

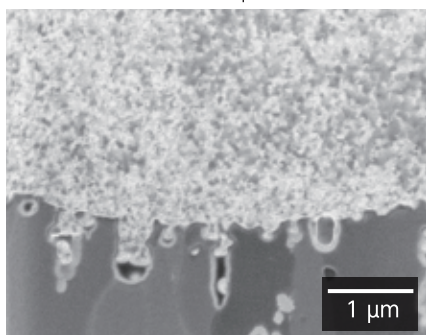
アルミスパッタ膜の局部腐食を抑制

Prevent local corrosion of aluminum sputtering layer

トップUBPプロセスW
TOP UBP PROCESS W



従来プロセス
Conventional process



無電解ニッケルめっき後の断面SEM像
SEM image of cross section(after electroless nickel plating)

